



高溶着・高速・低スパッタ 全てを叶える厚板プロセス

大電流パルス溶接システム

溶接時間

工程数が多く、
長時間作業

多層盛り

強度・品質確保に
複数パスが必須

後工程

スパッタ除去に
追加作業が発生



適用業種例



風力発電設備



圧力容器



橋梁



建築鉄骨



造船



高溶着で作業効率が1.5倍以上

1パスの溶着量増加、**多層盛りのパス数を低減**

適応例

対象ワーク

従来

大電流
パルス

建機
(アーム)

7パス

3パス

57%
削減

対象ワーク

従来

大電流
パルス

空調設備
(パイプ+フランジ)

3パス

1パス

66%
削減

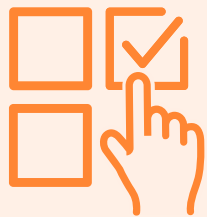


後工程が大幅低減

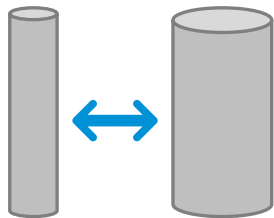
スパッタが少なく、きれいなビード外観

清掃・グラインダ工数低減





薄板から厚板まで1台で溶接可能 厚板溶接の高能率化を実現！



細径～太径まで対応

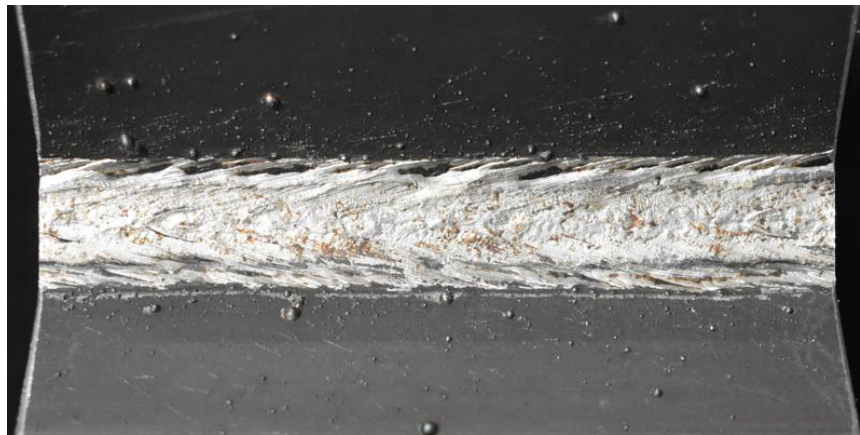
高能率パルス / 直流モードを含む多くのモード

材質 **板厚** **継手** に応じて最適な条件を選択

ワイヤ径 **$\phi 0.8\text{mm} \sim \phi 1.6\text{mm}$** まで対応

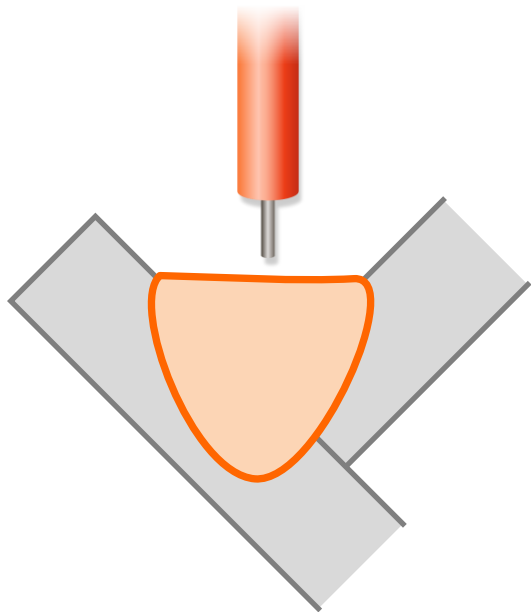
溶着量**約1.5倍**で、従来溶接より効率アップを実現

従来機直流溶接
500A 30cm/min



高能率パルス
650A 30cm/min





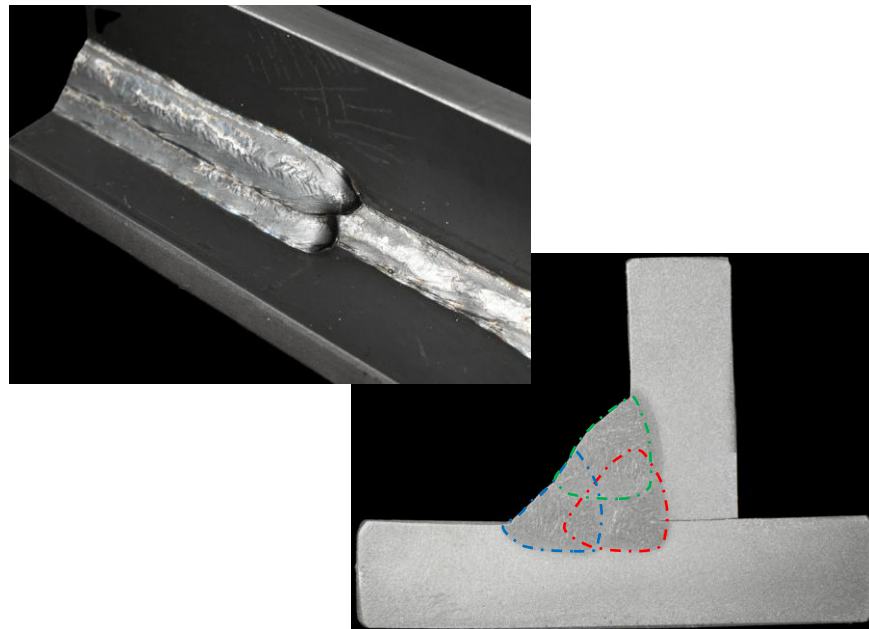
実演条件

溶接モード	高能率パルス
溶接条件	650A, 45V
溶接速度	30cm/分
材質・板厚	軟鋼 16.0mm
継手形状	下向きV受け
ガス・ワイヤ径	MAG, $\Phi 1.6\text{mm}$

1パス溶接



多層盛り溶接



大電流パルス溶接システムは
厚板溶接業界の高能率化に貢献します

DAIHEN